

「日米最先端エレクトロニクス実装教育セミナー」

現在、日本への先端半導体製造技術の移転が、ニューヨーク州政府/NYCREATES、ニューヨーク州立大学、IBMといった主要プレイヤーによって進められています。JIEP会員の皆様の中には、日本の半導体技術者がニューヨーク州に派遣されているというニュースをご存じの方も多いかと思います。

しかし、なぜニューヨーク州が世界最先端の半導体製造およびエレクトロニクス実装の拠点となっているのかについては、日本国内ではあまり知られていません。

実際、ニューヨーク州政府は過去20年間で約3.8兆円(25B USD)もの巨額な投資を行っており、2025年6月には、日本を含む他の地域（カリフォルニア州やテキサス州など）にも存在しないEUV

Acceleratorがオープンするなど、世界最先端の研究開発拠点としての地位を確立しています。また、GlobalFoundriesの工場や、建設予定のMicronの工場も立地しており、エレクトロニクス産業の集積地としても注目されています。

このような背景から、日本のエレクトロニクス実装技術、特に材料、装置、製造技術における国際的な競争力を維持するためには、ニューヨーク州の世界最先端研究拠点へのアクセスと技術交流が不可欠です。

本セミナーでは、日米の代表的な専門家による最先端エレクトロニクス実装技術に関する講義を通じて、技術的な交流を促進します。さらに、NYCREATESなどの担当者から、世界最先端の研究施設・設備の概要や利用方法についてもご紹介いただきます。

期 日：2025年12月3日（水） 12：00～15：00

開 催：オンライン開催（ZOOM使用）

【プログラム】 11：45 入室開始

12：00-12：10（時差の関係で12時開始になります。）

ニューヨーク州におけるエレクトロニクス実装研究拠点とは

教育事業委員会委員長/ニューヨーク州立大学教授 高松 誠一

12:10-12:50

(1) 【New York Center for Research, Economic Advancement, Technology, Engineering and Science（NYCREATES）の紹介】

Dr. David Haramie 氏

COO AIM Photonics, Associate Vice President Research Foundation SUNY /
NY CREATES

12:50-13:30

(2) 「半導体デバイス製造に用いられる接合技術の基礎と応用 – 直接接合からハイブリッド接合まで –」

東北大学教授 日暮栄治 氏

13:30-13:40

休憩

13:40-14:20

(3) 「Microstructure Engineering of Cu Interconnects in Hybrid Bonding for Scalable 3D Chip Integration（録画済みの講演）」

Professor Junghyun Cho 氏

State University of New York, Binghamton

14：20～15：00

(4) 「Chiplet and 3D Heterogeneous Integration Technologies for Scalable AI and HPC Systems（録画済みの講演）」

Principal Research Scientist, Katsuyuki Sakuma 氏

IBM Thomas J. Watson Research Center, Albany/Yorktown Heights

【参加要領】

定 員：WEB参加100名

締 切：2025年12月1日（月）

参加費：聴講料・テキスト代として（消費税込み）

正会員：5,000 円、賛助会員の社員：5,000 円

協賛会員：5,000円

賛助会員の社員（クーポン使用1枚）：無料

シニア会員：2,000 円、非会員：10,000 円

学生（会員）：無料、学生（非会員）：1,000円

名誉会員：無料

下記から参加申し込みをお願いします。

[会員](#)

[賛助会員](#)

[協賛会員](#)

[非会員](#)

注意事項(参加方法)

①申込が受理されますと、**返信メールで 公開研究会への参加 URLやお支払いに関する情報**をご連絡致します。

②ご申請の手順に従って、参加費のお支払いをお願い致します。

（お支払い方法：クレジットカード、コンビニ決済）

③請求書や振込確認後の領収書のご発行は、返信メールのマイページから出力が可能です。

④WEBの請求書が原紙扱いになりますので、ご了承ください。

⑤賛助・特別クーポンは、1枚/1口まで（複数口の場合は口数分）利用可能です。

申込時にクーポン番号等の全項目を記入しないと、利用できません。

* キャンセルポリシー

⑥参加費決済方法：クレジットカードかクレジット決済をご選択いただけます。

* キャンセルポリシー

お申込み後のキャンセルはできません。

問合せ先：TEL03-5310-2010 E-mail info@jiep.or.jp

教育担当

主催：一般社団法人エレクトロニクス実装学会
協賛：日本電子回路工業会（JPCA）